

PRÉSENTATION FLASH LABO : CEA-LETI

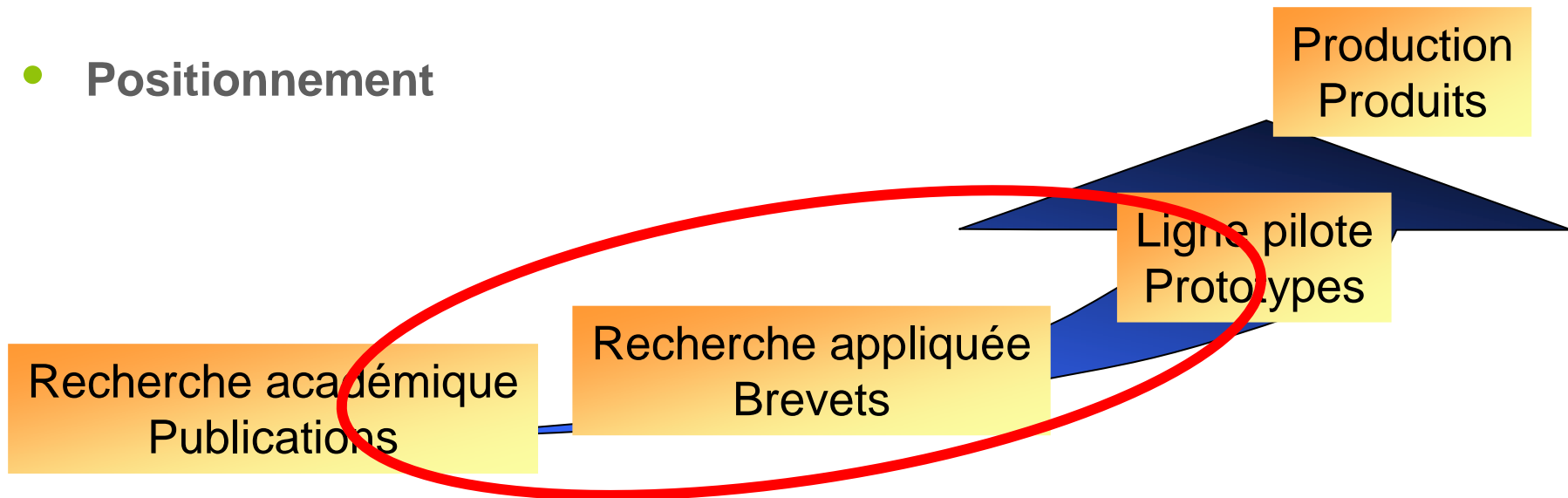
Journées du GdR META | A. Reinhardt | 07/06/16



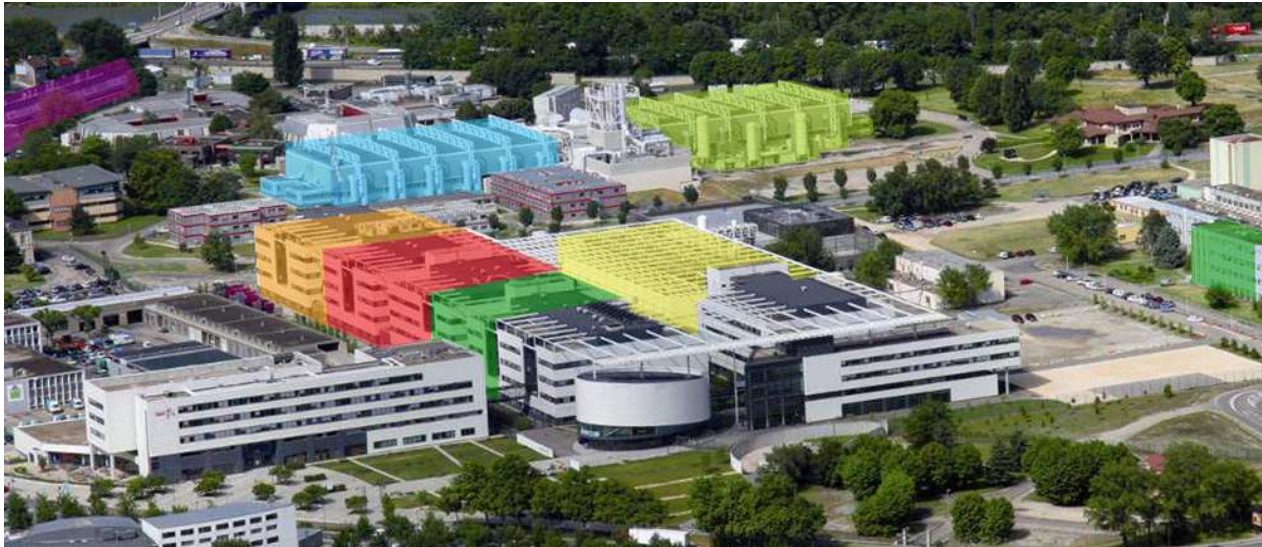











POSITIONNEMENT

- **Mission :**
Créer de l'innovation et la transférer vers l'industrie
- **Cœur de métier :**
 - Micro et nano-technologies, avec une masse critique sur leur intégration sur silicium
 - Composants avancés pour applications émergentes
- **Positionnement**



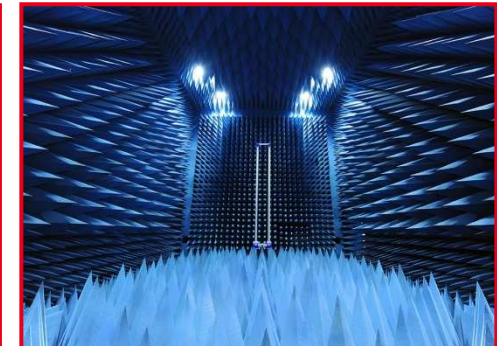
PLATEFORMES TECHNOLOGIQUES



-  **Nanotec 300**
-  **Advanced CMOS 200**
-  **MEMS 200**
-  **Nanoscale**
-  **Characterization**
-  **Smart Systems Integration**
-  **Design**
-  **Chemistry & Biology**
-  **Photonics**

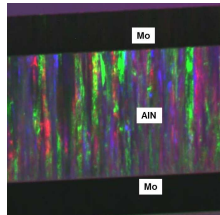
● **Salles blanches:**

- 100 mm : photonique et Plateforme Technologique Amont (PTA)
- 200 mm : CMOS et MEMS
- 300 mm : CMOS avancé
- 7000 m² en classe 10, fonctionnant 24h/24, 7j/7

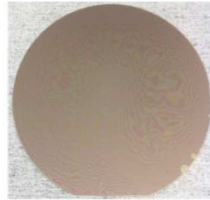


ACTIVITÉS ACOUSTIQUES AU CEA-LETI

Intégration de matériaux piézoélectriques :



Dépôts de matériaux piézoélectriques (AlN, PZT...)

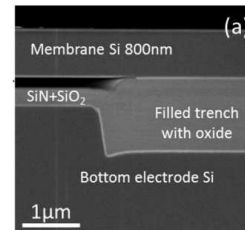


Report de couches minces monocristallines (LiNbO₃, LiTaO₃, Quartz, ...)

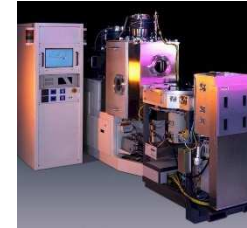


Caractérisations associées (XRD, MEB, TEM, ...)

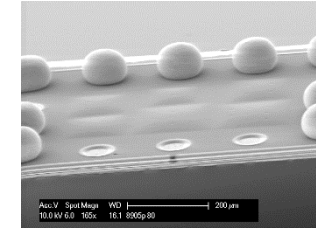
Procédés spécifiques MEMS :



Libération de membranes (DRIE, KOH, TMAH, HF, XeF₂, ...)

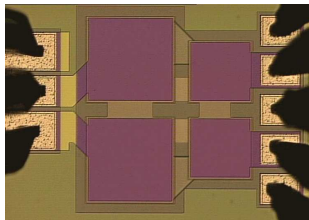


Correction de fréquence (trimming)

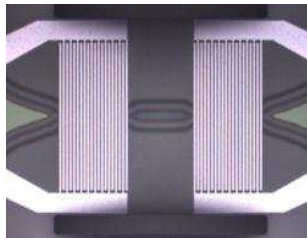


Encapsulation

Applications RF

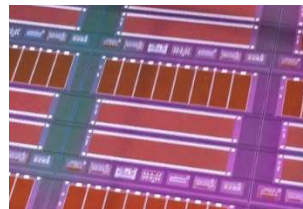


Filtres RF

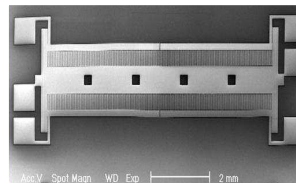


Composants à ondes de Lamb

Capteurs

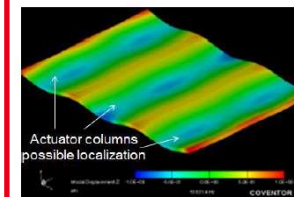


cMUT

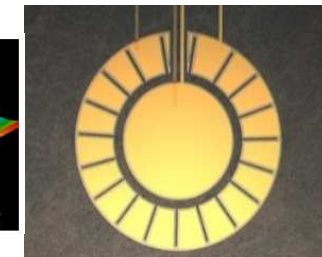


géophone

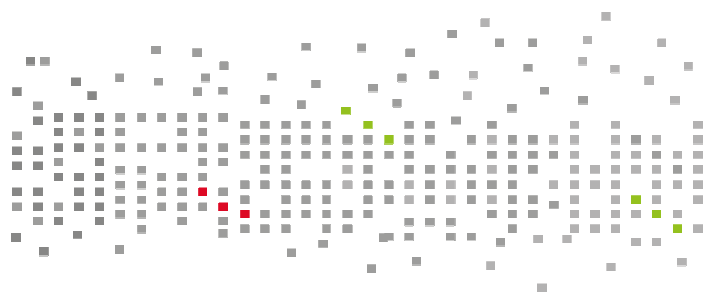
Actionneurs



Actionneur haptique



Haut-parleur digital



Leti, technology research institute

Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives
Minatec Campus | 17 rue des Martyrs | 38054 Grenoble Cedex | France

www.leti.fr



Planche de pictos

									
DISPOSITIFS MÉDICAUX	INTERNET DES OBJETS	CAPTEURS	IMAGING SENSOR	SERVEURS ET CALCUL INTENSIF	NANO ELECTRONIQUE	COMPOSANTS PHOTONIQUE	ÉNERGIE ÉLECTRONIQUE DE PUISSANCE	SÉCURITÉ	RF
									
									
									
									
0	1	2	4	3	5	6	7	8	9